



 住友チタニウム株式会社

平成17年2月18日

各 位

住友チタニウム株式会社
代表取締役社長 橋 昌彰
(コード番号：5726東証第二部)

中期経営計画(2005～2007年度)策定について

当社は、本日の取締役会において、別紙の通り「中期経営計画(2005～2007年度)」を決議いたしましたのでお知らせいたします。

以 上

<お問い合わせ先>

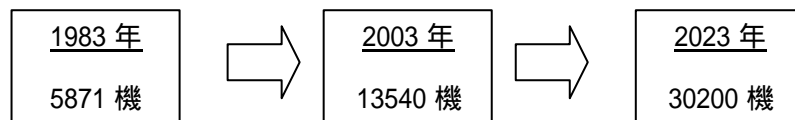
住友チタニウム株式会社 総務部
兵庫県尼崎市東浜町1番地 TEL.06-6413-9911

中期経営計画（2005～2007年度）

・中期経営計画の狙い

- ・チタン需要の半数近くを占める民間航空機向け需要は、9・11テロ、イラク戦争、SARS騒動により一時的な低迷を余儀なくされてきたが、昨年半ばより急速に回復を始め、A380(2006年就航)、B787(2008年就航)、A350(2010年就航予定)等の新機種就航は、将来に向けての順調な成長を期待させている。また、中国に於いてもハブ空港の設置等、航空機による交通網の拡充が急ピッチに進められている。

[参考：民間航空機の運行機数の増強展望(各年末運行機数)]



(出典：日本航空機開発協会資料より)

また、米英軍による次期戦闘機の配備(3000機)が、2008年より順次実施される等、航空機向けのチタン需要水準は極めて高くなってきている。

- ・航空機向け以外の分野でも、電力プラント、化学プラント、あるいは海水淡水化プラントの設置は、ここにきて大きなチタン需要に繋がりがつつある。特に、経済成長率の高い中国では、その動きが顕著となっている。
- ・当社の製品に関わりの高い半導体市場も、パソコンに加え、携帯電話、家電、更には自動車分野までその需要範囲を拡大させており、かつてのシリコンサイクルの波が縮小しつつあり、安定した伸びが期待できる。
- ・環境・エネルギー分野においても、地球温暖化問題から太陽光発電や水素エネルギー等のクリーンエネルギーへのシフトが進みつつあり、当社製品の適用に繋がる動きを見せ始めている。

このような状況認識の下、中期経営計画の目標を以下の通りとする。

<中期経営計画の目標>

1. 質・量総合して「世界トップのスポンジチタンメーカー」の地位強化
2. 「チタン」「半導体関連製品」「環境・エネルギー関連製品」の3本柱による収益力強化
3. 将来の経営基盤強化の為に「研究開発投資の拡充」と安価なスポンジチタンを製造する「新製錬法の開発促進」

[註] 半導体関連製品：多結晶シリコン、高純度チタン他
環境・エネルギー関連製品：SiO₂、粉末チタン、光触媒他

・中期経営計画の具体的施策

1．スポンジチタンの能力増強

・増強規模

18000t/年 → 24000t/年(+6000t)

【註】増強ステップ

第1期(05年10月稼働) 18000 22000t/年(+4000t)

第2期(06年4月稼働) 22000 24000t/年(+2000t)

・投資額

・第1期 47億円、第2期 16億円 合計 63億円

【註】増強内容

還元炉増設 :12炉
電解セル :3極 5極化
蒸留塔 :1基増設 他

現有設備は、能力的に見ると、上流工程(塩化)に余力がある為、下流工程(還元、電解)主体の能力増強投資を行う
これにより、上下工程ともバランスのとれた2000t/月体制を構築する。

【参考：各社の現状のスポンジチタン生産能力(当社推定)】

製造スポンジのグレード	航空機クリティカル [®] -ツ用途 生産可能			航空機左記以外の 生産可能		一般産業 民生用
	住友チタム	東邦チタム	Timet	AVISMA(ロシア)	UK-TMK(カザフスタン)	中国2社(遵義、撫順)
生産能力(千t/年)	18	13	9	27	19	5

全量 社内消費

【註】ロシアおよびカザフスタンスポンジの航空機クリティカル[®]-ツ分野への進出の動きが少しずつ出てきている。

2．スポンジチタン品質強化

低酸素、低Fe品等の高品質品へのユ-ザ-要望は日増しに増大しており、更に、航空機向け高品質品増量対応の為、一層の品質強化投資を実施する。

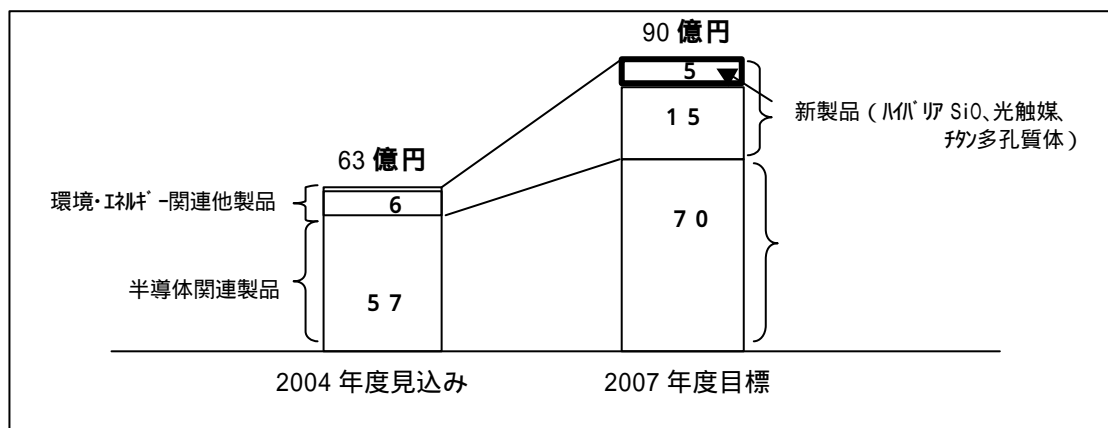
品質強化投資 投資額 8億円

(主な投資)

・破碎整粒工程での品質別ホッパ-増設 2億円
・破碎整粒工程のプレス機のパウ-アップ 2億円
・高純度チタン破碎設備の別棟化&空調強化 2億円

3. その他事業の強化

- 半導体関連製品 (多結晶シリコン、高純度チタン、四塩化チタン水溶液)
 - 多結晶シリコンについては、操業改善および更新投資による生産性向上を図り現状能力の800t/年を、900t/年に引き上げる
(なお、能力増強の為の投資は行わない)
- 環境・エネルギー関連他製品 (SD、ハイバリアSD、光触媒*、チタン多孔質体*、粉末チタン)
 - 注]*印 :ユ - ザ - にサンプル提供評価中
 - 環境問題の高まり 更にはクリーンエネルギー - 需要へのシフトに対応するべく 商品開発の強化を図り 上市を促進する
- その他事業の売上拡大目標



4. 3カ年累計設備投資額

(億円)

過去3年 (02~04年度) 設備投資額	本中期経営計画 (05~07年度) 設備投資額				
	チタン 能力増強	品質対応	新製品 対応	維持他	
51	63	8	4	55	

05年度 90
06~07年度 40

注]05~07年度累計償却費 100億円

- 上記投資額に対しては、極力内部留保で対応するが、年次別には大きくバラつく為外部資金調達も検討する。

5. 研究開発投資強化

(億円)

過去3年 (02~04年度) 研究開発投資額	本中期経営計画 (05~07年度) 研究開発投資額		
	商品開発	製造技術 開発	新製錬法 開発
14	8	14	6

- 新製錬法については、2007年度中に個別技術開発を完了させ、2008年度以降の「一体化ベンチプラント」建設を目指す。

・中期経営計画の数値目標

(為替レ - ト 100¥ / \$)

	2004 年度 見込み	2007 年度 目標
売上高	億円 205	億円 300 以上
チタン事業	142	210 以上
その他事業	63	90
(半導体関連製品)	(67)	(70)
(環境・エネルギー - 関連他製品)	(6)	(20)
経常利益	22	70
当期純利益	13.4	42
総資産	億円 320	億円 420
ROS (売上高経常利益率)	10.7%	20%
ROA (総資産経常利益率)	7.2%	16%

- 本中期経営計画は、今後のユ - ザ - ニ - ズに的確に対応すべく、能力増強、品質強化、旧設備の更新等、所謂、拡大再生産の為の投資を一気に集中して行う為、これらの投資資金の早期回収を最大の課題として、ハイリターンを目指した計画としている。
- 次々期中期経営計画 (2008~ 2010年度) は、新製錬法の事業化、ならびにチタン以外の事業分野の強化に注力する。

以 上

チタン製造フロ-

